



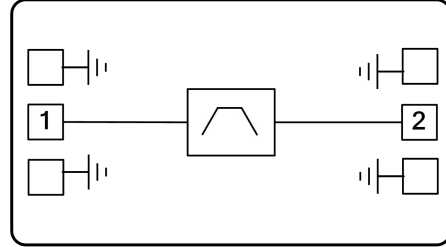
主要特点

- 通带频率: 21 – 23.2 GHz
- 中心损耗: 2.5 dB
- 阻带抑制: 34 dB @ 18 GHz
35 dB @ 25 GHz
- 回波损耗: 17 dB
- 芯片尺寸: 2 × 1.3 × 0.1 mm³

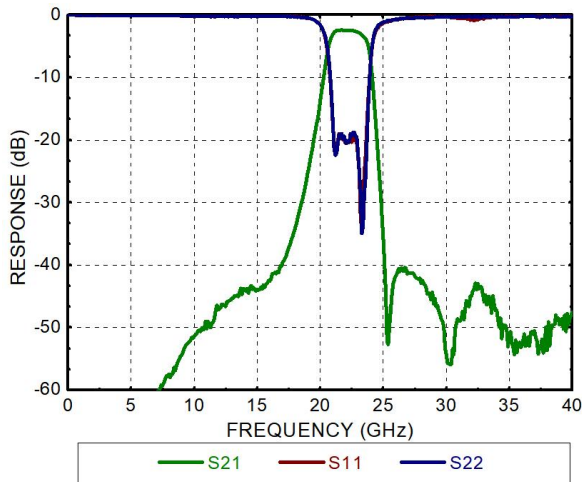
性能指标 (T_A = +25 °C)

参数	最小	典型	最大	单位
通带频率	21 – 23.2			GHz
中心损耗		2.5		dB
带内波动		0.5		dB
阻带抑制 @ 18 GHz		34		dB
阻带抑制 @ 25 GHz		35		dB
输入输出回波损耗		17		dB

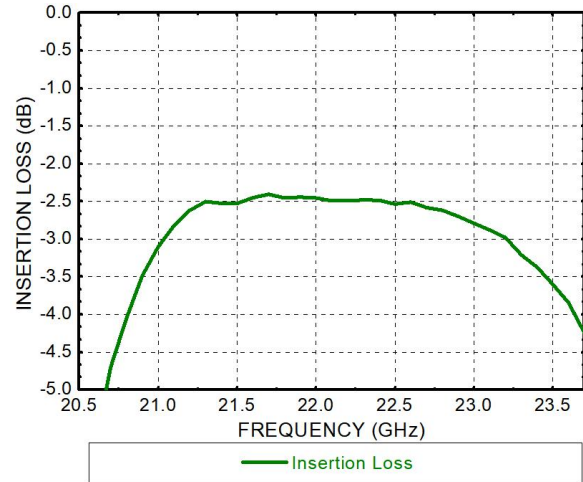
功能框图



反射系数

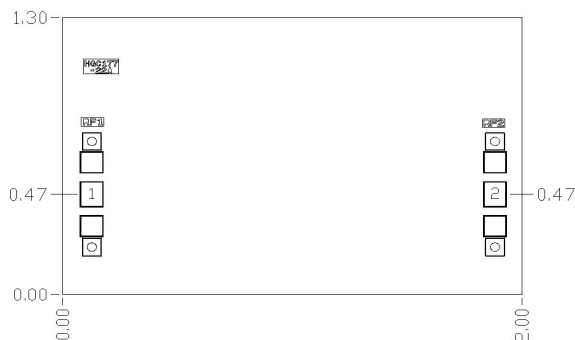


插入损耗



物理参数

单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是射频输入/输出端口
2	RF2	该焊盘是射频输入/输出端口



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度：
0.5+1.6 μm

极限参数

1. 射频输入功率：+30dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$